

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

(记录表编号：2025-0102)

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2025年1月2日-1月25日
地点/方式	券商策略会、现场调研
参与单位或 人员（排名 不分先后）	东方证券、东亚前海证券、光大证券、广发证券、国联证券、国泰君安证券、国投证券、国信证券、华福证券、世纪证券、天风证券、招商证券、东北证券、美银证券、中信证券、华创证券、中信建投证券、华泰证券、西南证券、国盛证券、平安证券、中金公司；贝莱德基金、博道基金、长城基金、创金合信基金、大成基金、富国基金、工银瑞信基金、广发基金、国泰基金、国联基金、汇丰晋信基金、交银施罗德基金、摩根基金、南方基金、诺安基金、诺德基金、泉果基金、融通基金、申万菱信基金、万家基金、兴全基金、易方达基金、源峰基金；长江养老、沅谊投资、高腾资产、Grand Alliance、国寿资产、禾其投资、红土创新、华夏未来资本、景林资产、聚鸣投资、Library Group、利幄私募、纽富斯投资、Point72、Millennium Management、太平洋资产、泰康资产、太平资产、星石投资、源乘投资、运舟资本、展博投资、中再资产、资瑞兴投资。
上市公司 接待人员	总裁：刘羽先生 董事会秘书：黄恬先生 证券事务代表：蒋靖怡女士
活动 主要内容	问：公司2025年在手订单情况如何？ 答：公司目前在手订单情况良好；市场对高频高速、高密度互联、大电

流、高散热等产品的技术要求不断升级和需求不断扩张，其收入增长潜力较大。

问：公司光模块业务进展？CPO 技术发展是否带来 PCB 规格提升？

答：公司已批量生产 10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品，完成 1.6T 光模块产品的打样并具备量产能力，批量订单导入正在持续进行。CPO 是一种新型的光电子集成技术，旨在将光学元件直接封装在芯片内部，从而实现更高密度的光电集成和更高性能的光通信系统。基于 CPO 技术的产品对所用 PCB 或在插拔稳定性及可靠性、散热、传输损耗等方面将提出更高要求。公司在 CPO 技术领域已有一定技术储备，未来 CPO 相关产品进展主要取决于市场的解决方案及客户的需求。

问：公司在数据中心领域是否有加大投入的规划？

答：随着 AI 技术不断演进，端侧应用探索加速，驱动行业对高层数、高频高速、高散热、高密度互联、低损耗等 PCB 产品的需求不断提升，公司将持续加大力度提升技术水平及市场份额，推动订单放量。

问：公司在 ASIC 产业链是否有布局？

答：近年来云厂商在 AI 相关基础设施建设领域积极布局，ASIC AI 服务器也成为诸多头部厂商尝试的路线之一。AI 服务器自研芯片的日趋成熟也将带来 PCB 市场的进一步扩容，公司与服务器厂商及 ODM 客户均保持良好的合作关系，努力推进定制化服务器相关产品的预研与打样。

问：未来公司在高端 PCB 如高多层、HDI 等领域是否有进一步扩展计划？

答：我们将根据客户的需求持续提升高多层、HDI 的产能。一方面，公司通过对现有工厂的产线和设备进行持续性改造升级，提升生产效率，未来能够进一步释放高端产能；另一方面公司也将结合自身经营业务规划和客户需求，合理配置新增产能。

问：新投产的信丰工厂新增产能情况？未来的产品定位是？

答：日前，公司信丰高多层电路板生产项目顺利投产，目前处于产能爬坡阶段，一期工厂产品以大批量 HLC 为主，可用于数通、消费电子、汽车电子、工业控制等领域。

	<p>问：公司计划什么时候披露 2024 年年度报告？</p> <p>答：公司 2024 年年度报告预计于 2025 年 4 月 29 日披露，敬请关注。</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件	无
记录时间	2025 年 2 月 5 日整理